

인용 발명 1: 한국공개특허 제1999-88521호(1999.12.27) 1부.

[국내 1부]

특 1999-0088521

(19) 대한민국특허청(KR)
 (12) 공개특허공보(A)

(94) Int. Cl.⁶
 (20) 31/25

(11) 공개번호 특 1999-0088521
 (43) 공개일자 1999년 12월 27일

1. 등록번호	10-1999-0018752
2. 출원일자	1999년 05월 26일
3. 출원번호	10-144557 1998년 05월 26일 일본(JP)
4. 출원인	아도 델카 가부시키가이샤 니끼우리 쇼오
5. 출원상	일본국 도쿄토 오다쿠니 미타 4초메 19번 7号
6. 출원자	우치노요시아키
7. 출원인	일본국 도쿄도 오다쿠니 미타 4초메 19번 7号
8. 출원인	구니노보세이이지
9. 출원인	일본국 도쿄도 오다쿠니 미타 4초메 19번 7号
10. 출원인	이관희, 이정훈

(54) 피고, 청취자 및 출전하기 위한 충돌장치의 구조

본inventor는 본invention을 출시된 환경조건에 배치된 피폭충돌장치를 축정기기에 전기적으로 접속하기 위한 접속부재와, 그 접속부재로부터 상기 피폭충돌장치를 그 접속부재상으로 반송하는 반송장치와, 피폭충돌장치의 리아드(리아드는 접속부재의 접촉자에 접촉시키는 접촉부재와, 판동하는 부학구성을 갖고, 그 부학구성에는 높은 충돌부재를 갖는 반송부재가 부착되고, 상기 피폭충돌장치의 리아드가 접속부재의 접촉자에 접촉된 때, 접속부재는 그 상대방인 리아드에 상기 피폭충돌장치에 접촉되고, 타단이 상기 힘온조 내부의 공기중에 접촉되어 있는 바운딩장치를 충당시켜 위한 충돌장치의 구조.

도 1-1은 본invention의 제작시예에 따른 고온변동력의 충정구조를 나타내는 단면도로서, IC를 IC충정기로 충정하고, IC는 상대방에 대비되는 단면도로서, IC를 IC충정기로 충정하고, IC는 상대방에 대비되는 단면도.

도 1-2는 본invention의 충정구조를 나타내는 단면도로서, IC소켓상에 IC를 반송해 온 상태를 나타낸다.

도 2-1은 제2급 사용태에 따른 고온변동력의 구조를 나타내는 단면도.

도 4-1은 차기구에 의한 고온변동력의 구조를 나타내는 단면도.

(이하에서 차기구란 대안 부호의 설명)

1. IC충정기	1a. 리아드
2. IC	2a. 접촉자
3. 차기구	4. 접속압축부재
4. 부착구멍	5. 방열봉등
5. 밸브	6. 용수첩

본invention은 차기구에 의한 고온변동력의 충정기로
 차기구는, 차기구의 피폭충돌장치를 가립해서 고온환경에서의 전기적특성을 축정하는 고온충정기능부식 오

그동안 제작한 B. 축정장치를 자동적으로 축정계통에 적용하여, 축점점과 예 기초해서 축정된 피축정장치를 사용함으로써 투표하고 수용하기 위한 장치이다.

도 40% 원내서, 1은 갑작화로, 즉, **폐통장장치**(이후, 단순히 'IC'라 칭한다), 2는 갑작화로스캔, 즉, 소액미지급, 단순히 'IC스캔'이라 칭한다), 3은 반송장치, 4는 접촉압축부재이다.

상호간 출판자(4)는 전자적으로 출판기(이하, 단순히 「IC 출판기」라 육성한다)에 의한 IC(1)의 전기적 특성의 측정에 관여하고 IC(1)의 리미드(1a)를 압축하여 리미드(1a)를 IC 소켓(2)의 접촉자(2a)에 접촉시킨다.

예를 들어, 소형 흡연 키트(1a)끼리가 단락하는 것을 방지하기 위해 접촉입출부지(4)는 합성수지 등의 출연재로 제작되었다.

③ 청구인은 그 혼인을 둘러는 가족끼리 가정원을 공기로 편에 의해 순환시키고, 혼인조내를 일정한 온도로 유지하므로 ④ 혼인조내의 IC(1)을 보정온도법 위대로 유지한다.

본문에서 본기부 협정을 체결하는 때에 한문조선의 협정문도 이상으로 10(1) 자체가 불법화

제 4 호 충청준의 IC(1)는 도 408 나타내는 비와 같이 IC소켓(2), 반도체장치(3), 및 전용암반(4)를 통한 바와 같이 한정수지이기 때문에 절전도를 더하고, IC(1)의

제11조(부록) 출판에 있어 때로는 II(1) 사제로부터의 할증률을 한은초내의 순환증기에 방열시키는 경우에 따른다.

제 2 장 대체로운 표준화율의 관리

상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 미투어진 것으로서, 전기적 특성의 축정 시에 있어서의 표준화, 관리에 의한 표준화장지의 운동성장을 억제하여 일정한 운동 범위에서 시의 표준화장지의 운동성을 위한 조작자와 그 과정을 고려하는 운동 유형으로 확장된다.

• 남 2000년 11월 23일 그림 그조를 가는 유통망과를 광고하는데 있다.

제작자들은 피교정장치를 자동적으로 육체적 제한에 적응하고 축성경과에 기초해서 육정된 피교정장치를 적용하고 수용하는 오토현율러를 적용할 수가 있지만, 또한 피교정장치의 전기적

이제 그만두고 하는 예술 놀면, 진적회로 키지를 적용할 수 있다.

그리고 대체로 허용되지 않고, 다른 전기장치도 적용가능하다.

이 일기는 향속 문양처의 전기적 특성을 측정하기 위한 것이다.

즉부분은 예상되며, 흐름정장치를 축정기에 전기적으로 접속할 수가 있는 소켓과 같은 것이 적용가능하

이전 스크립트를 위한 접속자를 갖고 있다.

그리고 그에 맞춰 리이드상호간의 드락을 방지하기 위해 합성수지와 같은 접연재료로 형성

제작부재의 접속자와 리아드를 접속시키기 위해 피속점장치의 리아드를 접속하기 위한

卷之三

그러나 예전 한글도지 않고, 높은 혼란성을 갖는 것은 아닐 것이다.

이전에 조작에 대한 우려가 있었지만, 최근에는 조작에 대한 우려가 줄고 있다.

한국에서 활동하는 노동자들이 있다.

그러나 그의 대안은 그의 대안이었지만, 그의 대안은 그의 대안이었다.

작 1999-0066521

방법으로, 그 영역 피속점장치에 접촉하는 방열부재의 일단으로부터 흡수되어서, 방열부재를 전도하여 방열부재의 다른 영역부터 핫온조내를 순환하는 공기중에 퍼져난다.

따라서, 피속점장치에 접촉가 블러시 피속점장치가 말영하도 피속점장치의 온도를 핫온조내의 온도에 균형화시키는 온도조건인 일정한 온도범위내로 피속점장치의 온도를 유지할 수가 있다.

그리고, 상기 일정한 온도범위내에서의 피속점장치의 전기적 특성의 특징이 가능하게 된다.

상기 방열부재를 접촉부재에 대해 상하방향으로 이동 가능한 상태로 부착시키고, 이 접촉부재가 상기 피속점장치를 커버하는 일정한 상태에 있어서, 방열부재가 자체증량에 의해 피속점장치를 일정한 상태로 상기 피속점장치를 유지 가능하다.

본 발명은 출입구부의 구조에 따르면, 접촉부재에 대해 상하방향으로 이동 가능한 상태로 방열부재를 부착시키고, 접촉부재가 피속점장치의 리아드를 일정한 상태에 있어서, 방열부재가 자체증량에 의해 피속점장치를 일정한 상태에서 피속점장치에 접촉하는 구성으로 했기 때문에 피속점장치로부터 방열부재로의 열전달이 감소된다.

방열부재를 상기 접촉부재에 대해 리아드의 일정방향으로 이동 가능한 상태로 부착시킴과 동시에, 접촉부재에 상하방향으로 상기 리아드의 일정방향으로 상기 방열부재를 힘을 기하는 흡수침을 부착시키고, 접촉부재에 상기 흡수침과 상호작용하는 리아드를 일정한 상태에 있어서, 상기 방열부재가 상기 흡수침의 기하는 힘에 의해 상기 피속점장치를 일정한 상태에서 피속점장치에 접촉 가능하다.

본 발명의 출입구부의 구조에 따르면, 접촉부재에 대해서 상기 일정방향으로 이동 가능한 상태로 방열부재를 부착시킴과 동시에 방열부재에 대하여 힘을 기하는 흡수침은 접촉부재의 부착구멍의 내부에 끌어당긴다.

따라서, 접촉부재에 의해 피속점장치의 리아드가 일정한 상태에서, 방열부재는 흡수침의 기하는 힘에 의해 피속점장치에 접촉 가능하게 된다.

그리므로, 접촉부재로부터 방열부재로의 열전도성이 높아진다.

방열부재는 방열부재의 다른 단면에 복수의 유험(凹凸)이 형성된 방열부를 구성할 수 있고, 방열부는 항온조내를 관통하는 공기에게 접촉 가능하다.

본 발명은 출입구부의 구조에 따르면, 방열부재가 다른 단면에 복수의 유험을 갖는 방열부를 갖고, 항온조내부에 통과하여 배치되어 있기 때문에, 피속점장치로부터 흡수한 열을 방열부로부터 항온조내의 출판부로 통과하여 출판부로 방열시키는 것이 가능해진다.

본 발명은 다른 선택에 의하면 피속점장치를 육장하기 위한 출입구부의 구조는, 일정한 온도로 유지된 항온조내부의 피속점장치를 육장기에 전기적으로 접촉하기 위한 접촉부재와, 상기 항온조외부로부터 접촉부재를 그 접촉부재상으로 반송하는 반송증거와, 접촉부재의 접촉자와 피속점장치의 리아드를 상호작용하는 부착구멍이 형성되고 높은 열전도성을 갖는 방열부재가 부착구멍에 부착되고, 피속점장치의 리아드가 접촉부재의 접촉자에 접촉되면 방열부재의 한 단면이 피속점장치에 접촉되고 다른 단면이 항온조내의 항온조내의 공기중에 접촉되는 구성으로 원피속점장치의 육장을 위한 출입구부의 구조이다.

이제 앞에서도 리아드를 접촉해서 상기 리아드를 상기 접촉부재의 접촉자에 접촉시키는 접촉압축부내와 접촉부재는 그의 일정방향으로 활용하는 부착구멍을 갖고, 그 부착구멍에는 높은 열전도성을 갖는 방열부재가 부착되고 접촉부재가 상기 피속점장치의 리아드를 접촉한 상태에서 상기 방열부재는 그 일정이상의 미세밀접식에 접촉되고, 단단이 상기 항온조내부를 승환하는 공기중에 배치되어 있는 구성으로 되어 있는 피속점장치를 육장하기 위한 출입구부의 구조이다.

즉, 미세밀접식은, 예를들면, 피속점장치, 흡정기, 접속부재, 반송증거, 및 상습한 것이 적용 가능하다.

접속부재에서는, 예를들면, 흡정증에 리아드 상호간의 단락을 방지하기 위해 할성수지와 같은 절연재료로 만든다.

접속부재는 접속부재와 접촉자와 리아드를 접촉시키기 위한 것이다.

접속부재에도 부착구멍이 형성되어 있으며, 부착구멍에는 높은 열전도성을 갖는 방열부재가 부착되어 있다.

방열부재는 피속점장치의 온도를 일정한 온도범위로 유지할 수 있도록 피속점장치에서 발생한 열을 방열부재로 부착구멍의 형상을 변형 가능하다.

본 발명은 출입구부의 구조에 따르면, 피속점장치의 리아드가 접촉부재의 접촉자에 접촉되면, 방열부재의 접촉부재는 미세밀접식에 접촉되고, 다른 단면을 항온조내의 공기에게 접촉된다.

따라서, 액체부재가 피속점장치에서 발생한 열을 방출하기 때문에 피속점장치의 온도를 항온조의 내부온도와 그 차이를 갖고, 일정한 온도범위로 유지하는 것이 가능하다.

그리고, 접촉부재는 전기적 특성을 일정한 온도범위에서 육장할 수가 있다.

또, 본 발명은 다른 형태에서는 오토밸브라는 상기 피속점장치를 육장하기 위한 구조로 구성된다.

본 발명은 오토밸브에 따르면, 피속점장치의 온도를 항온조의 내부온도와 균형하게 하는 것이 가능해진다.

본 발명은 항온조의 전기적 특성을 일정한 온도범위에서 육장할 수가 있다.

도시가 도시를 관조해서 본 발명의 실시예에 따른 고온전률러, 즉, 고온시험기능을 갖는 오트엔진리를
기초해 구체화 등장된다.

발명 제1항

도시는 도시는 본 발명의 제1의 실시예에 따른 고온전률러의 축점구조를 나타내는 단면도이다.

도시는 도시는 1000도에 의해 축점하는 상태를 나타내고, 도 2는 IC소켓상에 IC를 반송해온 상태를 나타내고 있다.

도시는 1은 2와 3은 IC, 즉, 퍼포먼스장치이고, 2는 IC소켓, 즉, 접촉부재로서의 소켓이며, 3은 반송장치로써 IC로부터 차운부재로서의 접촉입출부재, 5는 방열부재로서의 방열블록이다.

도시는 차운부재가 고온전률러는 퍼포먼스장치인 IC(1)를 기울여 고온환경에서의 전기적 특성을 측정하는 고온측정기장을 구비한다.

도시는 2는 IC(1)를 IC(1)를 IC(1)와 함께 퍼포먼스장치인 IC(1)와, IC(1)를 접촉하는 IC(2)과, IC(2)와 IC(1)를 접촉하는 IC(1)를 접촉하는 IC(1)와, IC(1)의 리미드(1a)를 접촉하는 리미드(1a)를 접촉자(2a)와 접촉시키는 접촉입출부재(14)와, IC(1)와 접촉해 IC(1)의 접촉면을 방열하는 방열블록(5)을 구비하고 있다.

도시는 2, 접촉면부재(14), 및 방열블록(5)은 일정온도로 유지된 항온조(도시상략)의 내부에 배치되어 있다.

도시는 IC(1)는 항온조의 내부를 IC(1)의 반송에 수반하여 이동한다.

도시는 항온조의 내부는 가열기 등에 의해 가열된 공기를 향해 의해 순환시키므로서 일정온도로 유지되고 있다.

도시는 IC(1)의 외부에 풍공부(2b)를 갖고 있으며, 그 풍공부(2b)에는 IC(1)의 리미드(1a)에 접촉하는 IC(1)과 그 외부에 접촉하지 않은 IC(1) 사이의 전기적 인터페이스(interface)를 형하는 접촉자(2a)를 구비하고 있다.

도시는 IC(1)을 위치를 정해서 유지하는 유지부(3a)를 구비하고, 그 하단면에는 수용하는 IC(1)의 하단면(11a)을 바탕으로부터 노출시키는 접촉부(3b)가 형성되어 있다.

도시는 IC(1)는 도시하지 않은 미동기구에 의해 항온조의 내부를 완벽히 동합한 동시에 도시하지 않은 승강기구에 의해 사용되고 강제해 IC(2)에 결합되고 분리된다.

도시는 IC(1)에 접촉하는 IC(1)의 리미드(1a)는 상기 접촉부(3b)를 거쳐 IC(1)의 접촉면부재(14)에 누워진다.

도시는 IC(1)는 IC(2)의 대향하는 위치에 배치되어서, 도시하지 않은 승강기구에 의해 상하방향으로 이동된다.

도시는 접촉면부재(14)는 IC(1)에 접촉하는 IC(1)에 리미드(1a)를 방지하기 위해, 예를들면 합성수지와 같은 절연재로 형성된다.

도시는 접촉면부재(14)는 그 하단에 리미드(1a)를 접촉해 IC(1)를 접촉자(2a)에 접촉시키는 접촉부(3a)로 구성된 IC(1)의 접촉면부재(14)의 거의 중앙에는 상하방향, 즉, 접촉방향으로 관통하는 부착구멍(14b)이 형성되어 있다.

도시는 접촉면부재(14)는 접촉면부재(14)에 대하여 상하방향으로 슬리미드 이동 가능한 접촉면부재(14)로 부착되어 있다.

도시는 접촉면부재(14)는 접촉면부재(14)에 대하여 상하방향으로 형성된다.

도시는 접촉면부재(14)는 접촉면부재(14)에 대하여 상하방향으로 형성된다.

도시는 접촉면부재(14)는 접촉면부재(14)가 도 2의 상태인 상승한 상태에 있어서, 그 접촉면부재(14)가 접촉입출부재(14)에 접촉해 접촉면부재(14)가 도 1과 같은 상태, 즉, 하강한 상태에서는 그 접촉면부재(14)는 IC(1)의 상단면에 맞닿아서 일어울려진다.

도시는 접촉면부재(14)가 하강한 상태에 있어서, 방열블록(5)은 자체증량에 의해 IC(1)의 상단면을 압축한 상대방식으로 IC(1)의 상단면에 맞닿아 있다.

도시는 IC(1)의 접촉면부재(14)에 접촉해도, 그 열은 명당하는 방열블록(5)의 하단면(5b)으로부터 방열하기 위한 풍공부(2b)로부터 항온조내를 순환하는 공기통으로 효율적으로 방열된다.

도시는 IC(1)의 온도를 항온조내의 설정온도에 균질시킬 수 있다.

도시는 IC(1)가 고온전률러의 축점구조의 동작에 대해 설명한다.

도시는 IC(1)가 도시하지 않은 미동기구에 의해 미동해서 항온조 외부의 IC(1)를 항온조 내부의 IC(1)로 대변하고 위치 속, 도 2의 위치로 반송한다.

도시는 IC(1)가 고온전률러의 축점구조의 동작에 대해 설명한다.

도시는 IC(1)가 고온전률러의 축점구조의 동작에 대해 설명한다.

[1] [1] 및 그 외 IC(1)에 수용되는 IC(1)의 리아드(1a)는 첨부(3b)를 거쳐서 IC소켓(2)의 접촉자(2a)상에 놓인다.

받은 접촉(3a)과 IC소켓(2)이 결합한 후, 접촉암축부재(14)가 습기구에 의해 하강해서 접촉암축부재의 압축부(14b)가 IC(1)를 압축하여 IC(1)를 접촉자(2a)에 접촉시킨다.

이때, 반대방향에 의해 IC(1)의 상단면을 일축한 상태에서 IC(1)의 상단면에 맞닿는다.

그리고 두 IC(1)에 있어서, IC(1)의 전기작동성이 확정된다.

이어서 IC(1)에 전기적 특성을 측정하기 위해 전류가 흐르고, 이에 의해 IC(1) 자체가 활성화된다.

마지막으로 IC(1)의 상단면에 맞닿는 방열블록(5)의 하단면(5a)으로부터 굽힘되어서, 방열블록(5)의 방열부(5a)로부터 같은 조건을 순환하는 공기중으로 효율적으로 방열된다.

다만, IC(1) 자체의 발광에 의한 IC(1)의 온도상승이 예상되어, 어떤 일정한 온도범위내에서 IC(1)를 관리해야 한다.

그러면 다음 같이 본 발명의 제1실시예의 고온밸러리에 따르면, 접촉암축부재(14)의 압축방향으로 판별하는 방열부(5a)에는 열전도성을 갖는 방열블록(5)이 부착되어 있어, 접촉암축부재(14)가 IC(1)의 리아드(1a)를 압축한 상태에서, 상기 방열블록(5)의 하단면(5a)이 IC(1)의 상단면에 맞닿는 한편 상단면의 방열부(5a)가 환온조(1b)를 순환하는 공기중에 배치되어 있기 때문에, 예를들면, IC(1)의 전기적 특성을 일정하게 유지하면서 IC(1)에 전류가 흐르려면 IC(1)가 활성화되도 그 옆은 IC(1)에 맞닿는 방열블록(5)으로 전도되어 방열블록(5)의 상단면의 방열부(5a)로 방열하고나마 그 공기중으로 방열된다.

마지막 IC(1)에 진류를 흘려서 IC(1)가 활성화되고 IC(1)의 온도를 환온조내의 온도로 균정시켜서 IC(1)의 IC(1)에 수반된 환온조 온도범위내로 IC(1)의 온도를 유지할 수가 있고, 상기 일정한 온도범위내에서의 IC(1)가 전기작동상의 유통성이 가능해진다.

또, 접촉암축부재(14)에 대해서 상하방향으로 이용가능한 상태로 방열블록(5)을 부착시키고, 접촉암축부재(14)가 IC(1)의 리아드(1a)를 압축한 상태에 있어서, 방열블록(5)이 자체증단에 의해 IC(1)를 압축한 상태에서는 IC(1)에 맞닿는 그선으로 헛기 때문에 IC(1)로부터 방열블록(5)으로의 열전도성이 높아진다.

마지막으로 IC(1)의 공기중에 배치되는 방열블록(5)의 일단면에 특수의 유통이 형성된 방열부(5a)를 습식하여 그 단면에 IC(1)로부터 흡수한 열은 방열부(5a)로부터 환온조내를 순환하는 공기중으로 효율적으로 방열된다.

제2) [1]

도 2는 본발명 제2실시예에 따른 고온밸러리의 유통구조를 나타내는 단면도이다.

본 실시예의 유통구조는 도 3에 나타내는 바와 같이, 접촉부자로서의 IC소켓(22), 반송장치(23), 접촉부자부설의 접촉암축부재(24), 방열부자로서의 방열블록(25), IC소켓(22)에 대해서 방열블록(25)을 일률 가진 조사 방우회(26)로 구성되어 있다.

제3) [1]에서는 도 3에 나타내는 바와 같이 지면에 대해 수직으로 놓인상태에서 IC(1)의 전기적 특성이 확정된다.

제4) [1]은 노출하지 않은 제1실시예와 같이 온도가 일정하게 유지되고 있는 환온조내에 수직으로 배치되는 접촉암축부재(14) 및 방열블록(25)은 IC소켓(22)에 대체해서 배치되어 있다.

도 4본 실시예는 도 3에 있어서 접촉으로 개봉된 증공부가 형성되어 있다.

제5) [1]은 도 4)는 도시하지 않은 IC(1)의 전기적 인터페이스를 수행하기 위해 제1실시예와 마찬가지로 주변기체 접트리(26)를 구비하고 있다.

제6) [1]은 리아드(1a)를 막축하여 리아드(1a)를 접촉자(22a)에 접촉시키기 위해 우측 단면에 악설(24)이 있다.

제7) [1]은 수평방향으로 판통하는 즉, IC(1)을 압축하는 방향으로 부착구멍이 형성되어 있다.

제8) [1]은 제1) 및 제2) [1]은 IC(1)에 접촉되는 방향으로 수평으로 이동한다.

제9) [1]에는 IC(1)을 위치결정하고 유지하기 위한 유지부(23a)를 구비하고 있다.

제10) [1]의 수축단면에는 IC(1)의 리아드(1a)를 우측으로부터 노출시키기 위한 침부가 형성되어 있다.

제11) [1]은 도시하지 않은 이동기구에 의해 일온조 내외간을 왕복 이동한다.

제12) [1]은 도시하지 않은 이동기구에 의해 IC(1)에 걸이맞추어지거나 분리되도록 수평으로 이동한다.

제13) [1]은 IC(1)에 접촉하는 IC(1)에 수동된 리아드(1a)는 첨부를 통해서 IC(1)의 접촉부(22a)에 접촉된다.

제14) [1]은 제1실시예와 같이 접촉암축부재(24)의 부착구멍에 판통하는 상태로 부착되어 있다.

제15) [1]은 예를들면 우수한 영전도성을 갖는 금속으로 형성된다.

방법통로(25)는 목수와 유클리드의 넓은 표면적을 갖는 좌측 단말부에 방열부(25a)를 구비하고 있다.

방법통로(25)의 내벽에는 용수철(26)이 배치되어 있다.

온수점(14)의 암근은 접촉압축부재(24)에 접속되어 있고, 한편, 타단은 방열블록(25)에 접속되어 있다.

방열부(25a)는 IC소켓(22)의 방향, 즉, 용수철(26)에 의해 IC(1)를 압축하기 위한 방향으로 힘이 가해져 있다.

압축압축부재(24)가 IC소켓(22)으로부터 분리된 상태에서 방열블록(25)의 방열부(25a)는 접촉압축부재(24)의 단단한 부재되어 있고, 접촉압축부재(24)가 IC(1)의 리미드(1a)에 접촉된 상태, 즉, 도 3에 나온 것과 같이 방열부(25a)의 반대측인 방열블록(25)의 우측 단말 표면은 IC(1)의 좌측 단말 표면에 접촉된다. 이는 방열부(25a)가 IC(1)의 리미드(1a)에 접촉된 상태에서, 방열블록(25)은 용수철(26)의 가하는 힘에 의해 IC(1)의 단단한 표면을 압축하면서 방열블록(25)에 대상하고 있는 IC(1)의 단단한 표면에 접촉되어 있다.

따라서, IC(1)은 용수철에 전류가 흐르면서 IC(1)가 발열하려도 그 옆은 방열블록(25)의 IC(1)에 접촉된 단단한 표면에 의해 속도되고, 방열부(25a)로부터 할온조내를 순환하고 있는 공기에 효율적으로 방열된다.

그럼으로 IC(1)의 발열에 의한 온도상승을 억제하는 것이 가능하고, 일정한 온도범위내에서 IC(1)을 측정하는 것은 주의가 필요하다.

다음과 같이 고온한 물리의 측정구조의 동작은, IC소켓(22), 반송장치(23), 접촉압축부재(24) 및 방열블록(25a)과 같은 부재로 이동할 수 있고, IC(1)가 용수철(26)의 가하는 힘에 의해 방열블록(25a)에 접촉되는 것을 제외하고는 제2설치예의 그것과 거의 동일하다.

방법통로(25)의 IC(1)를 할온조의 외부로부터 할온조 내부에서 IC소켓(22)에 대형화하는 IC(1)의 위치까지 이동하여 IC(1)에 대해서 같은 이동기구에 의해 이동된다.

방법통로(25)가 이동기구에 의해 우측으로 이동하면 반송장치(23)의 우측 단말부는 IC소켓(22)의 중공부에 접촉된다.

그러자 IC(1)을 할온조(23)의 IC소켓(22)은 상호 결합된다.

이제 IC(1)의 리미드(1a)는 청부를 통해서 IC 소켓(22)의 접촉자(22a)상에 놓여진다.

그리고 IC(1)의 리미드(1a)는 이동기구에 의해 우측으로 이동되고, 그러면 압축부(24a)가 리미드(1a)를 접촉하면서 접촉시켜 기노록 리미드(1a)를 압축한다.

마지막으로 압축부(24)는 용수철(26)의 가하는 힘에 의해 압축되면서 IC(1)의 좌측단말표면에 접촉된다.

이제 IC(1)은 도 3에 나온 바와 같이, IC(1)의 전기적 특성이 IC측정기에 의해 측정된다.

이제 IC(1)을 측정하기 위해 IC(1)에 전류가 흐르면 IC(1)는 열을 발생시킨다.

이제 IC(1)로부터 발생한 열은 방열블록(25)의 IC(1)의 좌측 단말 표면에 접촉된 우측 단말 표면에 의해 흡수된다.

마지막으로 IC(1)을 통해 전도되고, 방열블록(25)의 방열부(25a)로부터 할온조내를 순환하는 공기가 이를 흡수함으로써 강화된다.

마지막으로 IC(1)의 발열에 의한 온도상승을 억제하는 것이 가능하고, 일정한 온도범위내에서 IC(1)을 측정하는 것은 주의가 필요하다.

그리고 IC(1)의 물리의 제2설치예의 고온한 물리에 따르면, 방열블록(25)은 접촉압축부재(24)에 대한 접촉압축부재(24a)로 IC(1)을 부착되며, IC(1)의 내부부상은 부착되어 있다.

마지막으로 IC(1)에서 접촉압축부재(24)가 IC(1)의 리미드(1a)에 접촉되면, 방열블록(25)은 용수철의 가하는 힘에 의해 IC(1)을 압축하면서 IC(1)에 접촉되어 있다.

그리고 IC(1)은 전기적 특성이 IC(1)가 수직으로 위치한 상태에서 측정되면, 발생된 열을 방열블록(25)을 통해 둘레(14)에 각들이 전도시키는 것이 또한 가능하고, 발생된 열을 방열부(25a)로부터 할온조내를 순환하는 공기로도 강화적으로 방열하는 것이 가능해진다.

마지막으로 IC(1)을 온도범위내에서 IC(1)을 측정하는 것이 가능해진다.

이제 IC(1)에서는 흡강장치로서 오른한 물리를 적용했으나, 흡축장장치의 전기적 특성을 측정하는 다른 방법에도 적용 가능하다.

마지막으로 IC(1)은 IC(1)에 한정되는 것은 아니고, 다른 전기장치에도 적용 가능하다.

이제 IC(1)에 대하여 의하면, 전기적 특성의 측정시에 있어서의 흡축장장치자체의 힘에 의한 흡축장장치의 부착되는 환경에서 일정한 온도범위내에서의 흡축장장치의 측정을 가능하게한 흡축장장치의 측정을 위한 수단이나 그 수단이 제공된다.

설명 1

이것은 모두가 속자원형 운조내에 빼치된 피측정장치를 축정기에 전기적으로 접속하기 위한 접속부재와, 상기 칸트고 외부로부터 상기 피측정장치를 그 접속부재상으로 반송하는 반송장치와, 피측정장치의 리아드를 관통해서 상기 리아드를 상기 접속부재의 접속자에 접속시키는 접속부재를 구비하고 있으며,

상기 접속부재는 상기 접속방향으로 관통하는 부착구멍을 갖고 있으며, 상기 부착구멍에는 높은 열전도성
률을 갖는 탄온부()가 부착되어 있고,

상기 접속부재는 상기 피측정장치의 리아드를 암속한 상태에서 상기 방열부재는 그 일단이 상기 피측정장
치에 접속되고, 다른이 상기 탄온조 내부를 순환하는 공기층에 배치되는 것을 특징으로 하는 피측정장치
를 축정하기 위한 속정장치의 구조.

설명 2

기타설계 1) 예시

상기 탄온부()가 접속으로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축정하기 위한 속정장치의 구

설명 3

기타설계 2) 예시

상기 방열부재를 상기 접속부재에 대해 상기방향으로 이동 가능한 상태로 부착시키고, 상기 접속부재가
상기 피측정장치의 리아드를 암속한 상태에 있어서, 상기 방열부재가 자체 흡령에 의해 상기 피측정장치
를 접속한 상태로 상기 피측정장치에 맞접하는 구조로 되어 있는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축
정하기 위한 속정장치의 구조.

설명 4

기타설계 3) 예시

상기 방열부재를 상기 접속부재에 대해 리아드의 암을 방향으로 이동 가능한 상태로 부착시킴과 동시에 접
속부재를 고정하는 위치에 상기 리아드의 암을 방향으로 상기 방열부재를 밀을 가하는 용수철을 누적시키고,
상기 방열부재를 상기 피측정장치의 리아드를 암속한 상태에 있어서 상기 방열부재가 상기 용수철의 가하는 힘
에 의해 상기 리아드를 접속장치에 맞접하는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축
정하기 위한 속정장치의 구조.

설명 5

기타설계 4) 예시

상기 방열부재는 냉열부재의 다른쪽 달릴에 복수의 요철이 형성된 방열부를 구비하고, 방열부는 할온조내
로 축정되는 때에 접속되는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축정하기 위한 속정장치의 구조.

설명 6

기타설계 5) 예시

상기 칸트고 외부로부터 칸온조내에 빼치된 피측정장치를 축정기에 전기적으로 접속하기 위한 접속부재와,
상기 칸트고 외부로부터 상기 피측정장치를 그 접속부재상으로 반송하는 반송장치와, 상기 피측정장치의 리아
드를 관통해서 상기 리아드를 상기 접속부재의 접속자에 접속시키는 접속부재를 구비하고 있으며,

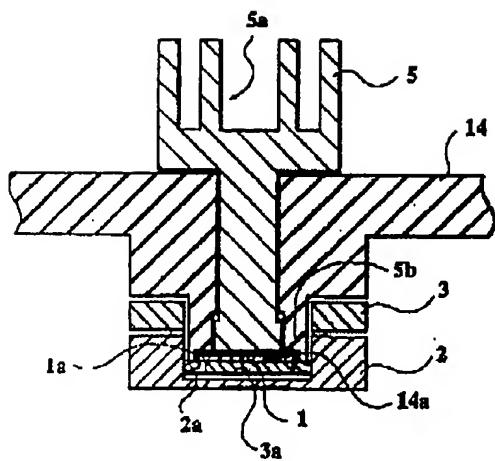
상기 접속부재는 관통하는 부착구멍을 갖고 있고, 상기 부착구멍에는 높은 열전도성을 갖는 방열부재가
상기 탄온조 내부에 접속되고, 탄온이 상기 탄온조 내부의 공기층에 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 피
측정장치를 축정하기 위한 속정장치의 구조.

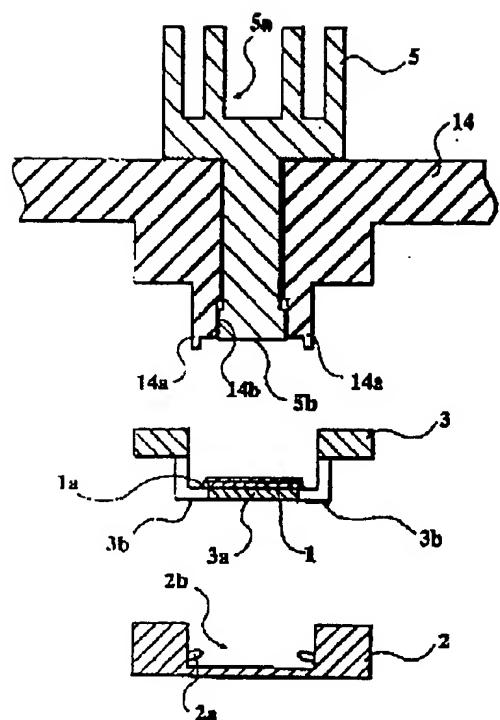
설명 7

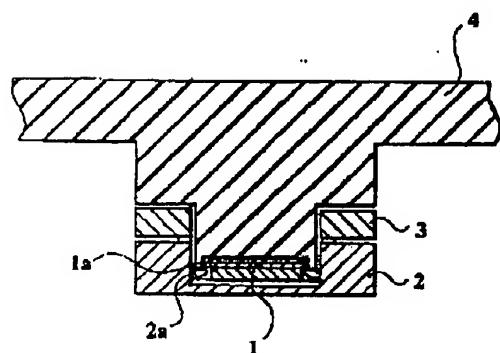
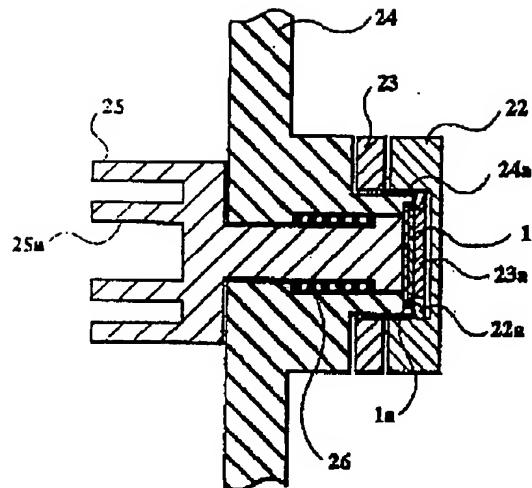
기타설계 6) 예시

상기 칸트고 외부로부터 칸온조내에 빼치된 피측정장치를 축정기에 전기적으로 접속하기 위한 접속부재와,
상기 칸트고 외부로부터 상기 피측정장치를 그 접속부재상으로 반송하는 반송장치와, 피측정장치의 리아
드를 관통해서 상기 리아드를 상기 접속부재의 접속자에 접속시키는 접속부재를 구비하고 있으며,

상기 접속부재는 냉열부재를 갖는 방열부재가 부착되고, 상기 피측정장치의 리아드가 접속부재의 접
속부재에 접속되고, 냉열부재는 그 일단이 상기 피측정장치에 접속되고, 탄온이 상기 탄온조 내부의 공기
층에 접속되어 있는 피측정장치를 축정하기 위한 속정장치의 구조.







10-10

10-10

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.